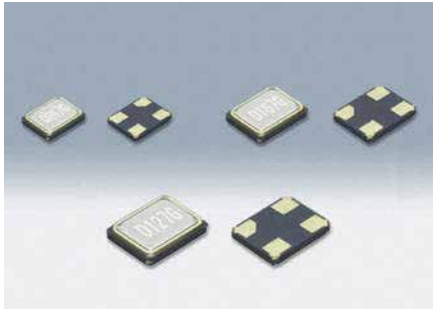


# 表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器

## DSX211SH/DSX221SH/DSX321SH



实际尺寸 DSX211SH □ DSX221SH □  
DSX321SH □

### ■ 优点

- 小型·薄型·SMD晶体谐振器 DSX211SH: 2016尺寸、厚度0.45mm  
DSX221SH: 2520尺寸、厚度0.45mm  
DSX321SH: 3225尺寸、厚度0.65mm
- 耐热性卓越, 高精度、高可靠性
- 支持广泛的频率 DSX211SH: 24MHz ~ 50MHz  
DSX221SH: 12MHz ~ 54MHz  
DSX321SH: 12MHz ~ 50MHz
- 无需防湿包装管理 Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)
- 依据AEC-Q200



### ■ 用途

- 通信机、近距离无线模块、DVC、DSC、PDA、PC等小型设备
- 多媒体设备等车载用途(依据AEC-Q200)

### ■ 一般规格

项目	型号	DSX211SH		DSX221SH			DSX321SH			
		频率范围	谐波次数	负载电容	激励电平	频率公差	串联电阻	频率温度特性	保存温度范围	包装单位
频率范围		24~30MHz	30~50MHz	12~16MHz	16~24MHz	24~30MHz	30~54MHz	12~20MHz	20~28MHz	28~50MHz
谐波次数		Fundamental								
负载电容		8pF, 10pF, 12pF								
激励电平		10μW (100μW max.)		10μW (200μW max.)						
频率公差		±20 × 10 <sup>-6</sup> (at 25°C)								
串联电阻		100Ω max.	80Ω max.	200Ω max.	150Ω max.	100Ω max.	60Ω max.	80Ω max.	60Ω max.	50Ω max.
频率温度特性		±30 × 10 <sup>-6</sup> / -30 ~ +85°C (Ref. to 25°C)								
保存温度范围		-40 ~ 85°C								
包装单位		3000pcs./reel(φ 180)								

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

### ■ DSX211SH

### ■ DSX221SH

### ■ DSX321SH

### [mm]

#### ■ 外形尺寸

2.05±0.1  
1.65±0.1  
0.45±0.05  
1.275  
0.975  
0.575  
0.475

#### ■ 内部连接

(Top View)

#1、#3为晶体端子  
#2、#4与防护罩连接  
#2、#4推荐与GND连接

#### ■ 焊盘图形(参考)

(Top View)

1.4  
1.1  
0.9

#### ■ 外形尺寸

2.5±0.15  
2.0±0.15  
0.45±0.05  
1.6  
1.25  
0.7  
0.65

#### ■ 内部连接

(Top View)

#1、#3为晶体端子  
#2、#4与防护罩连接  
#2、#4推荐与GND连接

#### ■ 焊盘图形(参考)

(Top View)

1.75  
1.3  
1.15  
1.0

#### ■ 外形尺寸

3.2±0.1  
2.5±0.1  
0.65±0.1  
2.1  
1.5  
0.9  
0.8

#### ■ 内部连接

(Top View)

#1、#3为晶体端子  
#2、#4与防护罩连接  
#2、#4推荐与GND连接

#### ■ 焊盘图形(参考)

(Top View)

2.2  
1.7  
1.4  
1.2